公司代码:688439　　公司简称:振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析 四、风险因素”

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.03元(含税),截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利140,600,000.00元(含税),占公司 2023年度归属于上市公司股东净利润的23.03%。

公司不进行资本公积转增股本,不送红股。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	振华风光	688439	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡锐	
办公地址	贵州省贵阳市高新区高坝路819号	
电话	0851-86303033	
电子信箱	irm@semifg.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售,主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品。公司持续进行产品迭代并不断扩展产品种类,形成放大器、转换器、接口驱动、系统封装和电源管理五大门类等200多款产品,广泛应用于特殊领域中,可满足全温区、长寿命、耐腐蚀、抗辐照、抗冲击等高可靠要求。2023年振华风光正式推出首款基于Risc-v架构研发的MCU产品,该产品集成32位内核,最高80MHz工作频率,内置最大256KB闪存、4KB EEPROM和80KB SRAM,支持工作在3V和5V的宽电压范围,ESD性能达8000V,可广泛应用于电机、通信和控制等领域,目前已顺利通过客户试用,正积极开展后续定型及量产工作。除此之外,振华风光在新布局的存储器和时钟电路方向上也取得重大突破,首款21GHz高频时钟缓冲器顺利通过鉴定检验,3款NAND存储器也已提交鉴定检验,上述产品的成功研发代表了公司坚持科技创新、持续提升研发水平,以满足用户需求为核心的经营战略。

1.放大器

2023年,公司在已研制的功率放大器、精密放大器、高速放大器等产品的基础上进行关键指标升级、门类拓展,攻克了大功率元胞晶体管设计技术、失调电压温度负载稳定性技术、扇顶微光修调技术、高隔离电压设计技术、可编程增益设计技术、动态校零及斩波调制技术、基极电流消除技术、全双极调制解调技术、浮动参考电压技术、抗辐照设计技术等关键技术,拓展了隔离放大器、跨阻放大器、抗辐照放大器等3个新门类5款产品,其中公司首款隔离放大器,隔离电压达到5kV,隔离放大器的特殊结构可解决医疗检测、便携测量等领域的高调电隔离、干扰屏蔽需求;基于钳位保护设计技术形成了2款新产品跨阻放大器,单位增益带宽达到200M,具有四种可编程增益模式,钳位电流:20-50mA,可用于光学测量、激光雷达接收机等领域;抗辐照放大器其出色的核加固特性在小卫星等特殊应用领域需求旺盛。产品性能方面迭代升级了零温漂精密放大器,低功耗轨至轨放大器,高压差分放大器等31款新产品,放大器产品功耗低至45μA,失调电压温漂低至5nV/℃,偏置电流低至1pA。基于动态校零及斩波调制技术开发了2款零温漂校零放大器,可实现超低水平的失调电压和温度漂移,失调电压温漂全温区范围内不超过5nV/℃,适用于传感器前端、医疗仪器和精密计量设备等应用场合。

2.转换器

2023年,公司对轨角转换器和磁编码转换器进行了一系列升级和研发,已扩展了2个门类(磁编码器和轨角转换器)5款产品,已攻克自动增益调节技术,霍尔感应器件设计技术,低噪声放大器技术,量程为0-3.3V的20Bit模数转换技术,360度的角度计算技术,自动延时补偿技术,可调的振荡器技术,开关电容技术、二类伺服环路技术、相位调制技术、ADC误差校准技术、比较器设计技术、精确电阻修调技术、版图设计技术、有源电容技术、高速SINC3模拟乘法技术等关键技术。开发的磁编码器达到14Bit精度,支持零位置编程,具有较强抗干扰能力,可广泛应用于汽车、工业自动化、无人机、机器人等领域。开发的轨角转换器将模拟电路和数字逻辑集成,用户可对轨角转换器的带宽、动态和速度比例进行设置,最高分辨率可达到16Bit,可应用于海、空、汽车、机器人等领域。

3.接口驱动

2023年,公司研制推出8款模拟开关新产品,突破了超低漏电补偿电路设计技术、低导通电阻平坦度设计技术、低电荷注入设计技术、高通道隔离度,解决了模拟开关信号传输精度低、信号传输损耗大、采集信号保持精度低和通道信号串扰等问题,可广泛应用于通讯、移动电子设备等场景,可为激光脉冲系统、信号传输系统和信号采集系统提供高精度、低损耗的传输信号;在栅极驱动器研制方面,推出4款新产品,突破了高压大电流、低延时、高集成度、小封装设计技术,解决了功率密度不足、传输速度慢、集成度低和封装尺寸过大等问题,可广泛应用于通讯、汽车、机器人、穿戴装备等场景,可为电机驱动系统和电源管理系统提供低延时、高功率密度的驱动信号。

4.系统封装集成电路

公司目标展系统封装集成电路业务以来，攻克了三维多基板堆叠封装技术、2.5D硅转接板设计技术、chiplet芯粒异构集成等关键技术,形成了从系统设计、模块设计、电路设计、可靠性设计到封装测试等全流程系统封装集成电路研发能力。现已形成电机驱动器、智能伺服控制器、传感器信号调理、存储器等系统解决方案,为客户提供更多系统级封装集成电路产品。下一步将加快高功率密度、高可靠异构集成产品制造能力建设,实现从陶瓷基板封装向硅基板封装的迭代升级,同时通过技术升级,定制具有竞争力的核心新品,加强产品之间的协同效应,减少元件之间互连数量和路径,提高集成密度,实现小型化封装,满足装备模块化发展对系统封装集成电路需求,实现快速增长。

5.电源管理器

2023年公司在已研制的线性稳压器、电压参考源、PWM控制器等产品的基础上开展了性能升级、谱系扩展等工作,攻克了抗辐照加固设计技术、片外数字校准技术、有源钳位设计以及高效率同步整流设计等关键技术。线性稳压器产品方面新增抗辐照产品6款,辐照等级达100KRad-Si,产品可广泛应用于深空探测;电压参考源方面突破片外数字校准技术及多阶温度补偿技术,解决了高精密基准源易受封装应力影响及温度影响设计难题,实现基准输出初始精度低于0.02%,温漂系数低至1ppm/℃,产品输出电压涵盖2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V,该系列产品被广泛应用于精密数据采集系统、工业控制系统、压力和温度变送器、光学控制系统、精密仪器等领域;PWM控制器方面,基于已有产品基础,基于电流模式及电压模式控制方式,开展了高压PWM控制器产品研究,形成了系列化高压PWM产品,该系列产品工作电压可覆盖8V-105V,开关频率可达2MHz,峰值输出电流可达3A,与此同时产品功能集成度更加多样化,芯片内部集成了可编程软启、可编程热关断保护、可编程欠压锁定、可编程死区控制、逐周期限流保护、集成半桥/同步整流FET等,该系列化高压PWM控制器产品可广泛应用于反激、正激、推挽、半桥以及全桥开关电源设计,其高开关频率、宽输入电压范围、高峰值电流驱动能力以及多功能集成设计能有效提升开关电源设计效率、功率密度以及降低系统设计复杂度。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司研发模式主要有两种:一是以满足用户需求为牵引方向的研发模式,将用户需求植入产品研发工作,为产品创新提供原创动力,创造出用户满意的优质产品;二是以公司产品技术发展为牵引方向的研发模式,通过公司开展前沿性的技术研究和开发,并根据市场发展趋势,自身发展战略等进行前瞻性布局,做好战略的技术储备,为未来市场拓展奠定产品研发基础。通过市场和技术两轮驱动,进一步提升了公司技术研发能力。

2.生产模式

公司目前在扬州集成电路工厂仍通过外协加工方式来满足生产需求,公司对外协厂商设置了严格的筛选制度,充分保证生产质量及供货速度,使公司各个生产环节有序高效进行。

公司生产模式主要根据在手订单情况或者客户需求预测安排生产计划。公司生产部门根据生产计划具体组织协调生产过程中各种资源,及时处理订单在执行过程中的相关问题,对质量、产量、成本、良率等方面实施管控,保证生产计划能够顺利完成,提高合同交付率。

3.销售模式

公司的客户主要为各大特种领域用户下属单位及科研院所,因此公司均采用直接销售的方式。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段和基本特点

根据前瞻产业研究院的测算,2025年,我国高可靠电子行业市场规模预计将达到5,012亿元,2021-2025年年均复合增长率将达到9.33%。集成电路产业是高可靠电子行业的重要支柱,长期以来,整个产业链都遭到不同程度的围堵或限制,受此不利局面影响,各类产品对集成电路的安全需求越发突出,一方面对企业法人的资质有严格的准入审查,另一方面对产品本身的可靠性也有多项考核要求,形成了资质、资金、技术、专用体系等多项壁垒,因此,国产化自给率仍有广阔空间及持续需求。在此背景下,整个产业链的发展也在不断重塑和升级,从原材料到应用端,随着技术水平的进步无疑会朝着低成本高质量的趋势演进,这些都充分反映出我国高可靠集成电路产业的发展仍处于高速发展阶段。

(2)主要技术门槛

集成电路产业包含设计、制造、封装、测试等诸多环节,均属于资金、技术、人才密集型产业。集成电路设计时不仅需要在体积、性能、安装方面满足技术要求,还需兼顾安全性、稳定性和抗干扰能力等多维度的环境要求,既要掌握各种器件结构、模型的应用特性,又要有深厚的技术积累和行业经验,才能保证产品的成功研发和量产。同时,集成电路产品更新速度快,产品种类、功能多,应用场景也不统一,需要多团队协同设计,除熟悉掌握芯片制造厂的工艺匹配情况,还应具备封装设计、测试(软硬件)开发、应用验证、故障分析、行业标准等各类专业知识,对研发团队的整体要求较高。企业必须保持优秀的创新能力,才能满足多变的市场需求。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司属高可靠集成电路行业,高可靠集成电路各产品种类和品类齐全,是信息化、智能化的基石,随着国家建设的有序推进,新增特殊领域产品的迭代升级将会为高可靠集成电路带来新的市场空间,高可靠电子产业也将进入新一轮的增长周期。

经过五十多年的发展,目前公司已拥有模拟、数模混合及系统集成的设计平台,具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力,以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力。公司始终围绕信号链和电源管理器等产品进行设计开发,持续进行产品迭代升级不断扩展产品种类,现已形成信号链及电源管理器两大类别共计200余款产品,是国内高可靠放大器产品谱系覆盖面最全的厂家之一,放大器和输角转换器产品在行业内占据重要地位,与同行业公司相比具有一定的竞争优势。2023年,公司持续加大科研投入,不断扩展产品谱系,推出的高输入阻抗运算放大器、轨到轨运算放大器、电流检测放大器、抗辐照器件等型号产品达到国内领先水平,已在各用户需求场景中推广应用,涉及信号处理、计算、驱动控制、电源等领域,业绩有望持续增长。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着工业技术水平的不断提升以及各种新型材料的更新应用,集成电路的发展也以集成度更复杂、性能更强大、速度更快、功耗更低为目标,一方面从芯片设计和工艺上寻求突破(以SoC为代表),另一方面通过封装工艺创新(以先进封装,多芯片堆叠为代表)。随着尺寸的不断缩小打破了元器件的物理极限,各种新型集成电路的技术得到了有效研究和应用,使得集成电路的应用范围更广,可兼容更多的技术,实现更多功能。

目前集成电路的需求和应用仍是启动现代化、智能化发展的关键要素,面对各类装备服役到期,亟需完成现代化升级改造的阶段目标,始终离不开高可靠集成电路的全面支撑,比如无人机、智能产品、AI算力、大模型分析等场景,都将跟随整个高可靠体系的建设提升而增长。

公司坚持瞄准国内高可靠市场需求,牢记使命责任,紧跟产品升级改造规划,稳步提升研发能力。同时基于MCU、存储器等核心芯片和先进封装能力,延伸产品应用场景,丰富产品谱系,以小型化、智能化、高集成化为目标,打造一体化集成电路产业生态,为用户提供完整的系统解决方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,360,467,694.95	4,819,929,654.45	11.21	1,269,429,174.38
归属于上市公司股东的净资产	4,728,955,491.23	4,193,871,940.97	12.76	619,102,695.07
营业收入	1,297,124,405.47	778,874,008.15	66.54	502,327,715.13
归属于上市公司股东的净利润	610,606,050.26	303,018,157.01	101.51	176,924,319.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,176,645.42	292,364,287.22	100.84	178,358,579.07
经营活动产生的现金流量净额	-32,355,025.14	-225,867,482.23	不适用	-20,963,330.22
加权平均净资产收益率(%)	13.71	16.32	减少2.61个百分点	35.70
基本每股收益(元/股)	3.0530	1.8181	67.92	1.1795
稀释每股收益(元/股)	3.0530	1.8181	67.92	1.1795
研发投入占营业收入的比例(%)	11.80	11.31	增加0.49个百分点	9.30

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	323,711,558.36	323,695,861.73	327,706,617.52	322,010,367.86
归属于上市公司股东的净利润	128,754,746.53	127,798,789.95	140,091,959.20	213,960,555.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,996,714.58	124,363,211.61	125,056,520.35	209,760,198.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,402,708.89	56,870,415.41	-49,688,664.29	-8,134,067.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,267
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国振华电子集团有限公司	0	80,239,970	40.12	80,239,970	80,239,970	无	0	国有法人
深圳市正和兴电子有限公司	0	39,311,534	19.66	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳前海捷创资本管理有限公司-枣庄捷凯创业投资合伙企业(有限合伙)	0	9,900,001	4.95	9,900,001	9,900,001	无	0	其他
平阳汇恒力合投资管理有限公司-厦门汇恒义合投资合伙企业(有限合伙)	0	7,350,001	3.68	7,350,001	7,350,001	无	0	其他
中电金投控股有限公司	0	5,842,388	2.92	5,842,388	5,842,388	无	0	国有法人
贵州风光智管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,869,867	1.93	0	0	无	0	其他
贵州风光芯管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,496,239	1.74	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	3,000,000	1.50	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	488,329	2,684,049	1.34	0	0	无	0	其他
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红-险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	8,929	2,250,482	1.13	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司,中国振华电子集团有限公司,中电金投控股有限公司间受中国电子实际控制;2.公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

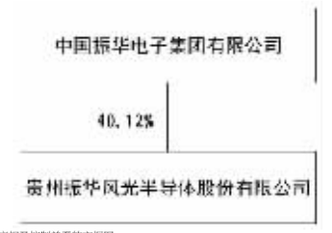
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688439　证券简称:振华风光　公告编号:2024-015

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月10日14点00分

召开地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年年度报告及摘要》	√
2	《2023年财务决算报告及2024年度财务预算报告》	√
3	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《2023年度董事会工作报告》	√
6	《2023年度监事会工作报告》	√
7	《关于2024年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于修订公司章程的议案》	√

注:本次股东大会将听取2023年度独立董事述职情况报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,内容详见公司于2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案9

3.对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、深圳市正和兴电子有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688439	振华风光	2024/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师:北京市中伦律师事务所。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月7日8:30-17:00

(二)登记方式:可采用现场登记、信函或邮件方式登记,通过信函或邮件方式登记的,信函或邮件需在2024年5月7日17:00前送达,邮箱:irm@semifg.com。

(三)登记地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司董事会办公室

(四)登记手续:

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、委会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4.异地股东可以信函、邮件方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

5.上述授权委托书至少应当于2024年5月6日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东或代理人请提前一个小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号

联系人:董事会办公室

电话:0851-86300002

电子邮箱:irm@semifg.com

邮政编码:550018

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2024年4月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州振华风光半导体股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年年度报告及摘要》			
2	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》			
3	《关于2023年度利润分配预案的议案》			
4	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》			
5	《2023年度董事会工作报告》			
6	《2023年度监事会工作报告》			
7	《关于2024年度董事薪酬的议案》			
8	《关于2024年度监事薪酬的议案》			
9	《关于修订公司章程的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688439　证券简称:振华风光　公告编号:2024-010

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营和业务发展的实际需要,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-一规范运作》等规定,对《公司章程》进行修订,该议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后生效,具体修订内容如下:

公司章程内容修订对照表

修订前	修订后
第五条:公司住所:贵州省贵阳市白云区高坝路819号	第五条:公司住所:贵州省贵阳市高新区高坝路819号
第十二条:依法登记,公司的经营范围为:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定未规定许可(审批)的,市场主体自主选择经营(集成电路芯片及产品制造,电力电子元器件制造;电机及其控制系统研发;集成电路制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造)	第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定未规定许可(审批)的,市场主体自主选择经营(集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电力电子元器件制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电机及其控制系统研发;半导体分立器件制造;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广)。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议,审议通过后生效,修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。公司董事会同时提请股东大会授权负责办理上述章程备案登记等相关手续。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:688439　证券简称:振华风光　公告编号:2024-013

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年4月26日(星期五)上午 9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心图文展示和网络文字互动问答

投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@semifg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日发布公司2023年年度报告,并将于2024年04月25日发布公司2024年第一季度报告。公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.03元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币140,600,000.00元(含税),占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为23.03%,公司本次不进行资本公积转增股本,不送红股。相关公告详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-010)。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况以及2023年度现金分红具体情况,公司计划于2024年4月26日(星期五)上午9:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动问答形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况以及2023年度现金分红具体情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月26日(星期五)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:图文展示和网络文字互动问答

三、参加人员

董事、总经理:赵晓辉先生

独立董事:董延安先生

副总经理、董事会秘书:胡锐先生

副总会计师:张博学先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月26日(星期五)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱irm@semifg.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系方式:0851-86303033

电子邮箱:irm@semifg.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司
董事会
2024年4月20日

证券代码:688439　证券简称:振华风光　公告编号:2024-014

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金实际到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1334号)同意注册,并经上海证券交易所同意,贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3,349,500,000.00元,扣除全部发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币3,259,923,588.89元。上述募集资金已全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2022年8月23日出具了《验资报告》(中天运〔2022〕验字第90043号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日,本年度使用募集资金人民币313,896,916.84元,累计使用募集资金总额人民币950,555,966.84元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为54,838,856.46元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币60,208,078.30元,募集资金余额为人民币2,369,575,700.43元,其中用于现金管理金额为1,285,000,000.00元。

截至2023年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币1,084,575,700.43元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专户年初余额	2,628,633,760.81
加:年初用于现金管理金额	
募集资金年初余额	2,628,633,760.81
加:扣除手续费后的利息收入净额等	54,838,856.46
减:募集资金项目的支出	44,752,216.84
永久补充流动资金的金额	30,000,000.00
购买土地使用权在建工程金额	239,144,700.00
期末用于现金管理未收回金额	1,285,000,000.00
募集资金专户期末余额	1,084,575,700.43

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市